



WHITE PAPER

Europäische Elektronikfertigung 2026 | EMS, PCB und Halbleiter im Umbruch

Fabriken, Start-ups, Verteidigung und Konsolidierung – was sich 2026 in der europäischen Elektronikindustrie tatsächlich bewegt

Dirk Kaussen | EMS Strategy Group | Rev.: 1.0 | 24. September 2026

1. Einleitung

Das Jahr 2026 bringt für die europäische Elektronikindustrie mehrere relevante strukturelle Veränderungen. Während in Dresden der Rohbau der neuen ESMC-Fabrik steht und Infineon seine Smart Power Fab in Betrieb genommen hat, fließen erhebliche Mittel in Halbleiter-Start-ups, und die EU-Kommission leitet mit dem Chips Act 2.0 die nächste Phase ihrer Strategie ein. Zeitgleich entwickelt sich die Verteidigungselektronik zu einem wichtigen Nachfragetreiber, während der europäische EMS-Markt von einer zunehmenden Konsolidierung geprägt wird.

Diese Entwicklungen betreffen nicht nur die Halbleiterfertigung. Sie reichen über Packaging und Testing bis zu Leiterplatten, Elektronikfertigung und internationalen Lieferketten. Für OEMs verändert sich damit das Umfeld, in dem Produktions- und Beschaffungsentscheidungen getroffen werden.

2. Chipfertigung nimmt sichtbar Form an

In Dresden zeichnet sich derzeit eines der bedeutendsten europäischen Halbleiterprojekte ab. Die European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC) – ein Joint Venture von TSMC (70 %), Bosch (10 %), Infineon (10 %) und NXP (10 %) mit einer Gesamtinvestition von rund zehn Milliarden Euro – feierte im September 2026 das Richtfest für den Rohbau.

Das Vorhaben wird mit bis zu fünf Milliarden Euro staatlicher Beihilfe durch Deutschland gefördert, was von der EU-Kommission offiziell genehmigt wurde. ESMC plant, 2027 die ersten Fertigungsanlagen in den Reinraum einzubringen. Bei voller Auslastung ist eine Kapazität von 480.000 300-mm-Wafern pro Jahr beziehungsweise 40.000 Wafern pro Monat vorgesehen. Gefertigt werden sollen Technologien im Bereich 28/22 nm sowie 16/12 nm FinFET. Die Anlage ist insbesondere auf Automotive- und Industrieanwendungen ausgerichtet.

Bis zur Serienfertigung stehen allerdings noch anspruchsvolle Phasen wie die Reinraumeinrichtung, Anlagenqualifizierung und der Ramp-up bevor. Die von der EU genehmigte Planung sieht den Betrieb bei voller Kapazität ab 2029 vor.

Ergänzend eröffnete Infineon am 2. Juli 2026 seine neue Smart Power Fab in Dresden mit einem Investitionsvolumen von fünf Milliarden Euro. Die Fabrik schafft rund 1.000 neue Arbeitsplätze und verdoppelt die Produktionskapazität am Dresdner Standort. Gefertigt werden Leistungshalbleiter

sowie Analog- und Mixed-Signal-Komponenten für unter anderem Automotive, Industrie, erneuerbare Energien und die Energieversorgung von KI-Rechenzentren.

Auch im Back-End-Bereich entstehen neue Kapazitäten. Die Europäische Kommission verlieh Silicon Box im italienischen Novara im März 2026 den Status einer „Open EU Foundry“. Das Projekt umfasst eine fortgeschrittene Packaging- und Testing-Fertigung, in der unter anderem mehrere Dies beziehungsweise Chipllets in einem gemeinsamen Package integriert werden.

Für OEMs verdeutlichen diese Vorhaben, dass europäische Halbleiterpolitik nicht nur auf klassische Wafer-Fabs setzt, sondern zunehmend auch nachgelagerte Prozessschritte einbezieht. Dennoch ersetzen die neuen Kapazitäten globale Lieferketten nicht kurzfristig. Differenzierte Beschaffungs- und Second-Source-Strategien bleiben daher unverzichtbar.

3. Politischer Kurswechsel – vom Kapazitätsaufbau zur Ökosystem-Wertschöpfung

Der ursprüngliche European Chips Act mobilisierte nach Angaben der Europäischen Kommission erhebliche öffentliche und private Investitionen und hat bereits zu neuen Produktions- und Entwicklungskapazitäten in Europa geführt.

Am 3. Juni 2026 legte die Europäische Kommission den Vorschlag für einen Chips Act 2.0 vor. Dieser zielt darauf ab, die europäische Halbleiterindustrie weiter zu stärken, strategische Abhängigkeiten zu reduzieren, fortgeschrittene und Mainstream-Technologien abzusichern und die Krisenvorsorge zu verbessern. Der Vorschlag befindet sich weiterhin im Gesetzgebungsverfahren.

Damit verschiebt sich der politische Fokus von der reinen Fabrikkapazität hin zu einem ganzheitlicheren Ökosystem. Eine Chipfabrik allein gewährleistet noch keine vollständige Resilienz der europäischen Wertschöpfungskette. Zwischen Wafer und Endprodukt liegen weitere kritische Stufen wie Packaging, Testing, Leiterplatten (PCB), Spezialchemikalien und EMS-Fertigung, bei denen weiterhin erhebliche außereuropäische Abhängigkeiten bestehen.

Die Europäische Kommission berücksichtigt im Rahmen des Chips Act bereits ausdrücklich neben der Halbleiterfertigung auch Advanced Packaging, Testing und Assembly.

Für die industrielle Praxis bedeutet dies: Der Ausbau der Halbleiterfertigung ist ein wichtiger Baustein, kann aber nur im Zusammenspiel mit den übrigen Produktions- und Lieferketten zu einer breiteren Absicherung der europäischen Elektronikindustrie beitragen.

4. Kapitalfluss in europäische Halbleiter-Start-ups

Europäische Halbleiter-Start-ups verzeichnen weiterhin eine hohe Finanzierungsdynamik. Laut PitchBook-Daten sammelten sie 2025 insgesamt 972 Millionen Euro in 69 Finanzierungsrunden ein. Im ersten Quartal 2026 überschritt das Finanzierungsvolumen bereits 380 Millionen Euro.

Ein Beispiel für diese Entwicklung ist das niederländische Start-up Axelera AI aus Eindhoven, das im Februar 2026 mehr als 250 Millionen US-Dollar aufnahm und damit seine Gesamtfinanzierung auf mehr als 450 Millionen US-Dollar steigerte. Das Unternehmen will damit die Entwicklung und Skalierung energieeffizienter KI-Beschleuniger und seiner Chiptechnologien vorantreiben.

Solche Start-ups konkurrieren meist nicht über schiere Fertigungsmasse, sondern besetzen technologisch anspruchsvolle Nischen mit hoher Wertschöpfung. Die Entwicklung zeigt das weiterhin hohe Investoreninteresse an europäischen Halbleiter- und Hardwareunternehmen.

5. Verteidigungselektronik als neuer Nachfragetreiber

Mit dem European Defence Industry Programme (EDIP) hat die EU 2026 ein Instrument zur Stärkung und Modernisierung der europäischen Verteidigungsindustrie geschaffen. Das am 30. März 2026 verabschiedete Arbeitsprogramm umfasst 1,5 Milliarden Euro für die Jahre 2026 und 2027. Davon sind mehr als 700 Millionen Euro für Maßnahmen zur Verstärkung europäischer Produktionskapazitäten vorgesehen. Dazu gehören unter anderem elektronische Schlüsselkomponenten, Verteidigungsplattformen sowie unbemannte und gegen unbemannte Systeme gerichtete Technologien.

Die vorgesehenen Förderquoten liegen je nach Ausschreibung zwischen 35 und 100 Prozent der förderfähigen Projektkosten.

Für EMS-Dienstleister entstehen damit zusätzliche Markt- und Fördermöglichkeiten, insbesondere bei elektronischen Schlüsselkomponenten und verteidigungsrelevanten Systemen.

Dieser Markt stellt zugleich hohe Anforderungen an Rückverfolgbarkeit, Qualität, Qualifikation und Dokumentation. Für EMS-Betriebe kann dies gezielte Investitionen in Kapazitäten, Prozesse, Qualitätssysteme und Produktionsinfrastruktur erforderlich machen.

6. Konsolidierung im europäischen EMS-Markt

Während der globale EMS-Markt 2025 weiter wuchs, blieb Europa hinter den asiatischen Wachstumsraten zurück. Gleichzeitig ist der europäische Markt mit mehr als 2.000 kleineren und mittleren EMS-Unternehmen weiterhin stark fragmentiert. Vor diesem Hintergrund hat sich die Konsolidierung 2026 spürbar fortgesetzt.

Drei prominente Beispiele verdeutlichen den Trend:

1. Kontron

Kontron bündelt die Aktivitäten von Kontron, KATEK und beflex electronic unter der Servicemarke „Electronics²⁴“, um seine Position im europäischen ODM-/EMS-Geschäft weiter auszubauen.

2. HANZA / BMK

HANZA schloss am 7. Januar 2026 die Übernahme der BMK Group GmbH ab. BMK beschäftigt rund 1.500 Mitarbeiter in Augsburg und verfügt zusätzlich über Aktivitäten in Tschechien. Mit der Übernahme erweitert HANZA sein europäisches Produktionsnetzwerk erheblich.

3. Incap / Lacon

Incap schloss am 19. Februar 2026 die Übernahme der Lacon Group ab. Damit wurden die deutschen und rumänischen Standorte in das Incap-Netzwerk integriert. Die Übernahme stärkt insbesondere die Aktivitäten in Deutschland und die Kompetenzen in den Bereichen Defense, Railway Technology und Medical Technology. Insgesamt kamen mehr als 600 Mitarbeiter und vier Produktionsstandorte hinzu.

Für OEMs bieten größere EMS-Netzwerke breitere Kapazitäten, internationale Standorte und mögliche Beschaffungsvorteile. Gleichzeitig verändert sich durch die Konsolidierung die Struktur des Marktes. OEMs müssen ihre EMS-Lieferantenbasis daher kontinuierlich hinsichtlich Eigentümerstrukturen, Ansprechpartnern, Kapazitäten und Standortprioritäten evaluieren.

Die Konsolidierung bedeutet dabei nicht automatisch, dass kleinere EMS-Anbieter ihre Bedeutung verlieren. Für bestimmte OEM-Anforderungen können spezialisierte oder regional ausgerichtete Fertigungspartner weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Die Auswahl des geeigneten Partners wird jedoch stärker davon abhängen, welche Kombination aus Technologie, Standort, Kapazität, Flexibilität und finanzieller Stabilität benötigt wird.

7. Industrielle Basis und ZVEI-Positionen

Auf Verbandsebene wuchs 2026 das Bewusstsein für die strategische Relevanz der gesamten Elektronik-Wertschöpfungskette. Daniel Hager wurde im Mai 2026 zum ZVEI-Präsidenten gewählt. Zu den vom ZVEI hervorgehobenen Themen gehören unter anderem Wettbewerbsfähigkeit, Elektrifizierung und Digitalisierung.

Der ZVEI warnt vor einer weiteren Erosion der europäischen industriellen Basis. Nach Angaben des Verbandes ist Europas Anteil an der weltweiten Leiterplattenproduktion von rund 20 Prozent im Jahr 2000 auf etwa zwei Prozent zurückgegangen. Bei der Elektronikfertigung liegt Europas Anteil inzwischen bei rund zehn Prozent.

Der Verband fordert daher eine stärkere De-Risking-Strategie und eine Stärkung der europäischen Elektronikfertigung.

Der Ausbau der Halbleiterfertigung allein schließt die bestehenden Lücken bei Basismaterialien, Laminaten und Leiterplatten nicht. Gerade in diesen Bereichen bestehen weiterhin erhebliche Abhängigkeiten von internationalen Lieferketten.

Damit wird deutlich, dass eine robuste europäische Elektronikindustrie nicht allein über zusätzliche Wafer-Fabs aufgebaut werden kann. Ebenso relevant sind verfügbare PCB-Kapazitäten, Materialien, Komponenten, Packaging, Testing und EMS-Fertigung.

8. Fazit

Ende September 2026 liegen konkrete Entwicklungen vor: Der ESMC-Rohbau steht, Infineons Smart Power Fab ist eröffnet und erweitert die Produktionskapazität in Dresden, Silicon Box hat den Status einer „Open EU Foundry“ erhalten und der Chips Act 2.0 zielt auf eine stärkere Absicherung und Weiterentwicklung der europäischen Halbleiter-Wertschöpfungskette. Gleichzeitig schaffen das EDIP-Arbeitsprogramm und die Konsolidierung im EMS-Sektor neue Rahmenbedingungen für Elektronikhersteller und deren Lieferketten.

Für OEMs ergibt sich daraus kein Grund für eine pauschale Re-Shoring-Strategie nach Europa, da globale Lieferbeziehungen auch künftig unverzichtbar bleiben. Notwendig ist vielmehr eine differenzierte Sourcing-Strategie.

Europäische Kapazitäten können wertvolle Absicherungen für kritische Anwendungen, kurze Lieferketten und bestimmte regulierte Märkte schaffen. Gleichzeitig bleiben internationale Beschaffung, globale Kostenstrukturen und Second-Source-Ansätze wichtige Bestandteile einer resilienten Lieferkette.

Die strategische Aufgabe für OEMs besteht daher weniger darin, globale Lieferketten grundsätzlich durch europäische Strukturen zu ersetzen. Entscheidend ist vielmehr, die eigene Wertschöpfungskette hinsichtlich Technologie, Risiko, Kosten, Verfügbarkeit und geografischer Abhängigkeiten neu zu bewerten und die jeweiligen Produktions- und Beschaffungsstandorte entsprechend auszubalancieren.

Für die Elektronikfertigung bedeutet 2026 damit vor allem eines: Europa baut an mehreren Stellen wieder industrielle Kapazitäten auf. Die Wirkung dieser Investitionen wird jedoch davon abhängen, ob neben Halbleitern auch die übrigen Stufen der Wertschöpfungskette – von PCB und Materialien über Packaging und Testing bis hin zur EMS-Fertigung – ausreichend berücksichtigt werden.

Quellen

European Commission

Strengthening Europe's tech sovereignty, 3 June 2026.

European Commission

European Chips Act.

European Commission

Chips Act 2.0 – Proposal and supporting documents, 3 June 2026.

European Commission

Commission approves €5 billion German State aid measure to support ESMC in setting up a new semiconductor manufacturing facility.

Sächsische Staatskanzlei

Richtfest der European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC) in Dresden, September 2026.

ESMC – European Semiconductor Manufacturing Company

Informationen zum ESMC-Halbleiterwerk Dresden.

TSMC

European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC) – Dresden.

Infineon Technologies AG

Infineon opens new Smart Power Fab in Dresden, 2 July 2026.

European Commission

Open EU Foundry status granted to Silicon Box for innovative chiplet facility, March 2026.

Halbleiter-Start-ups und Finanzierung

PitchBook

European Semiconductor Startups Cash In as VCs Turn to Hardware, 2026.

Axelera AI

Company and financing announcements, February 2026.

Verteidigungselektronik und EDIP

European Commission

European Defence Industry Programme (EDIP) – Work Programme 2026–2027, 30 March 2026.

European Commission

EDIP – Commission adopts €1.5 billion work programme to boost European and Ukrainian defence industry, 30 March 2026.

European Commission

EDIP Work Programme – Factsheet, 2026.

EMS-Markt und Konsolidierung

HANZA AB

HANZA completes acquisition of BMK in Germany, 7 January 2026.

Incap Corporation

Incap completes acquisition of Lacon Group, 19 February 2026.

Incap Corporation

Lacon companies officially operating under the Incap name, 2026.

Kontron AG

Electronics² – Kontron, KATEK and beflex electronic.

in4ma

European EMS Market Analysis and Market Data.

Evertiq

European Electronics Manufacturing Services Market and M&A Developments, 2026.

Europäische PCB- und Elektronikfertigung

ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V.

Strengthening Europe's PCB and Electronics Manufacturing for Critical Infrastructure, 2025.

ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V.

Informationen zur europäischen Leiterplatten- und Elektronikfertigung.

ZVEI

Daniel Hager zum ZVEI-Präsidenten gewählt, 20 May 2026.

Über den Autor

Dirk Kaussen ist Gründer und Geschäftsführer der EMS Strategy Group. Mit rund 40 Jahren Erfahrung in der Elektronikindustrie — darunter die Gründung einer eigenen Elektronikfertigung in Deutschland — verfügt er über tiefgreifende Expertise in Fertigungsprozessen, EMS-Partnerauswahl, Lieferkettenstabilität, Verlagerungsprojekten und Risikomanagement. Sein Ansatz verbindet praxisnahe Lösungen mit direktem Bezug zur industriellen Realität.

Über die EMS Strategy Group

Die EMS Strategy Group unterstützt Industrieunternehmen bei der strategischen und operativen Weiterentwicklung ihrer Elektronikfertigung. Schwerpunkte sind die strategische Verlagerung von Fertigungsvolumen, die Auswahl qualifizierter EMS-Partner, der Aufbau neuer Produktionskapazitäten sowie die Erweiterung bestehender Fertigungsstrukturen.

Darüber hinaus sichern wir Lieferketten durch Risikoanalysen, Dual-Sourcing-Strategien und maßgeschneiderte Supply-Chain-Konzepte, mit operativer Begleitung bis zum Serienhochlauf.

www.emssg.com | [LinkedIn: Dirk Kaussen](#)

Rechtlicher Hinweis / Haftungsausschluss

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Analysen und Empfehlungen wurden mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Sie dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken im B2B-Kontext und stellen keine Rechts-, Steuer-, technische oder betriebswirtschaftliche Beratung dar, die auf eine spezifische Situation zugeschnitten ist. Die Inhalte dieses Dokuments können und sollen eine individuelle, qualifizierte Fachberatung oder wirtschaftliche Machbarkeitsstudien nicht ersetzen. Alle genannten Markt-, Statistik- und Brancheninformationen basieren auf öffentlich zugänglichen Quellen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung.

Regulatorischer Vorbehalt: Da sich gesetzliche Vorgaben, Richtlinien, Normen und deren offizielle Auslegungsvorschriften (insbesondere auf EU- und internationaler Ebene) kontinuierlich weiterentwickeln, spiegeln alle Angaben den Stand zum Zeitpunkt der Erstellung wider. Sie stehen unter dem ausdrücklichen Vorbehalt späterer offizieller Veröffentlichungen oder Gesetzesänderungen. Ausschließlich die offiziellen Gesetzestexte und behördlichen Publikationen sind rechtsverbindlich.

Gewährleistungs- und Haftungsausschluss: Obwohl alle zumutbaren Anstrengungen unternommen wurden, um die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen zu gewährleisten, übernimmt die EMS Strategy Group keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung oder Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte.

Soweit gesetzlich zulässig, ist jegliche Haftung der EMS Strategy Group für direkte, indirekte, zufällige, Folge- oder sonstige Schäden ausgeschlossen, die aus der Nutzung, dem Vertrauen auf oder der praktischen Umsetzung von Informationen, Strategien, Empfehlungen oder Bewertungskriterien dieses Dokuments entstehen.

Urheberrecht und Weitergabe: Dieses Dokument darf in seiner ursprünglichen, unveränderten Form weitergegeben und geteilt werden, vorausgesetzt, die vollständige Nennung und Urheberbezeichnung der EMS Strategy Group bleibt jederzeit erhalten.

Steuerrechtliche Abgrenzung / Keine Steuerberatung: Soweit in diesem Dokument steuerliche oder abgabenrechtliche Aspekte angesprochen werden, erfolgt dies ausschließlich im Rahmen einer allgemeinen strategischen oder wirtschaftlichen Betrachtung und nicht als individuelle steuerrechtliche Prüfung, Beratung oder Gestaltung. Die EMS Strategy Group übernimmt keine auf den konkreten Einzelfall bezogene Hilfeleistung in Steuersachen. Die Beurteilung konkreter steuerlicher Auswirkungen und die Entwicklung oder Prüfung steuerlicher Gestaltungen sind einem hierzu befugten Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwalt oder einer sonst gesetzlich befugten Stelle vorbehalten.



www.emssg.com | LinkedIn: Dirk Kaussen

© 2026 EMS Strategy Group. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf mit Quellenangabe frei zitiert werden.